

公司代码：605358

公司简称：立昂微



杭州立昂微电子股份有限公司

2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每10股派发0.85元现金红利（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为676,855,027股，扣除回购专户中股份数量2,593,500股，现金股利分派的股份基数为674,261,527股，以此计算预计派发现金红利57,312,229.80元（含税）。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	立昂微	605358	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴能云	李志鹏
办公地址	杭州经济技术开发区20号大街199号	杭州经济技术开发区20号大街199号
电话	0571-86597238	0571-86597238
电子信箱	wny@li-on.com	lizhipeng@li-on.com

2 报告期公司主要业务简介

2023年，受到全球经济持续疲软、通货膨胀高企、消费需求减弱、地缘政治危机等多重因素影响，全球半导体行业呈现波动下行的趋势。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2023年全球半导体产业销售额达5,201.26亿美元，同比下降9.4%。2023年中国半导体行业同样面临行业周期下行、市场低迷、贸易环境不稳定等多重考验，2023年国内半导体行业进出口同比下降。根据海关总署公布的2023年度进出口主要商品数据，2023年全年集成电路出口2,678.30亿个，同比下降1.8%；全年集成电路进口4,796亿个，同比下降10.8%。

2023年，面对市场下滑、订单不足、折旧成本高企等现实挑战，公司牢把方向、紧判大局、抓住节点、负压前行。凭借独立自主的核心技术研发体系，高效的市场快速反应能力，准确把握定制化产品与客户库存回补等订单机会，紧抓光伏、工控、汽车电子等领域中的结构性机会，在产品价格下降的大趋势下，不断加大研发投入，持续提升技术研发水平；不断加大市场开拓力度，增加市场占有率，成功开发标志性大客户，为公司实现可持续发展打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入268,966.99万元，较上年同期的291,421.63万元下降7.71%；实现营业利润-9,870.76万元，较上年同期的71,645.57万元下降113.78%；剔除利息、折旧摊销等因素的影响后，EBITDA（息税折旧摊销前利润）为86,696.93万元，较上年同期的134,922.98万元下降35.74%；实现归属于上市公司股东的净利润6,575.25万元，较上年同期的68,778.99万元下降90.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,552.44万元，较上年同期的55,653.97万元下降118.96%。

影响2023年度公司业绩下降的主要因素有：

1、产能扩产带来的成本压力。公司部分募投项目自2022年6月开始陆续转固，相应的折旧费用、水电气等固定成本相比上年同期增加了14,355.25万元，叠加2022年下半年开始市场需求下滑，抛光片产能利用率下降，给公司带来了较大的成本压力；

2、收购嘉兴金瑞泓产生阶段性的亏损。2022年3月份公司收购了嘉兴金瑞泓，2023年仍处于产能爬坡过程中，相比上年同期亏损增加8,073.76万元；

3、计提的可转换债券利息费用大幅增加。公司2022年11月发行了33.90亿元的可转换债券，2023年度计提利息费用12,630.54万元，较上年同期增加10,976.82万元，影响了业绩；

4、产品降价导致毛利率大幅下降。受宏观经济、市场需求方面的影响，公司主要产品售价相比2022年有所下滑，其中半导体硅片折合6英寸的平均售价下降12.86%，半导体功率器件芯片的平均售价下降12.33%，叠加固定成本增加和抛光片产能利用率下降的影响，导致综合毛利率由2022年度的40.99%下降至2023年的19.57%，减少了21.42个百分点。

5、公允价值变动收益减少。2023年度公司持有的上市公司股票股价变动产生公允价值变动收益1,822.72万元，与上年同期的3,341.63万元相比，减少1,518.91万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为102,679.73万元，与上年同期的119,454.25万元相比，减少16,774.52万元，降幅14.04%；投资活动产生的现金净流出186,068.49万元，与上年同期的474,491.64万元相比，减少288,423.15万元，降幅60.79%，主要系上年同期支付了收购嘉兴金瑞泓的股权款及本期购建固定资产支付的现金相比上年同期大幅减少共同影响所致；筹资活动产生的现金净流出67,526.34万元，较上年同期减少398,650.01万元（上年同期为净流入331,123.67万元），主要系公司上年同期发行33.90亿元可转换债券、本期银行借款减少及本期支

付远期回购义务款项共同影响所致。

报告期末，公司总资产 1,827,599.25 万元，较期初下降 1.43%；总负债 873,025.85 万元，较期初上升 0.11%；归属于上市公司股东的净资产 797,235.30 万元，较期初下降 2.83%。

报告期内，公司开展的经营工作主要情况如下：

1、紧抓市场机遇，销量创出新高

面对半导体市场的新形势新变化，公司及时部署和动态调整硅片与芯片板块的产能匹配、产能分工，深入调研和分析市场，积极协同客户，加快产品结构调整，发挥重掺产品优势，在市场需求变化中寻求增量，多措并举抓销量。半导体硅片折合 6 英寸销量 984.36 万片（含对立昂微母公司的销量 192.50 万片），较上年同期增长 0.72%。功率器件芯片销量 171.58 万片，较上年同期增长 8.87%，创下历史新高，出现了沟槽 SBD 和 FRD 芯片快速上量、IGBT 芯片开始小批量出货等积极变化，实现了在清洁能源、车规、工控及消费电子领域的全覆盖，使得公司抗风险能力加大。化合物射频芯片销量 1.79 万片，较上年同期增长 141.19%，亦创下新高。

2、坚定创新战略，实现技术突破

报告期内，公司研发费用支出 27,921.11 万元，占营业收入比例为 10.38%；上年同期研发费用支出 27,182.45 万元，占营业收入比例为 9.33%。公司始终保持研发的高投入，报告期内公司研发项目主要以大尺寸半导体硅片的生产工艺技术、化合物半导体射频芯片的生产工艺技术和高端的功率器件芯片的生产工艺技术研发为主。

在半导体硅片领域，公司 12 英寸产品已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路，以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件。轻掺产品不断拓展客户群体，重掺产品和技术继续保持全球领先优势。

12 英寸硅片开发了双极型-CMOS-DMOS(BCD)器件用、高压集成电路（HVIC）及电源管理集成电路（PMIC）器件用硅抛光片；动态随机存取存储器（DRAM）器件用（高带宽存储器 HBM）、闪存器件用（NOR 型和 NAND 型 Flash）硅抛光片；逻辑器件用（Logic IC）、图像传感器（CIS）器件用及 BCD 器件用硅外延片；IGBT 器件用及 Super Junction 器件用厚层硅外延片；金属-氧化物-半导体场效应晶体管（MOSFET）器件用超低阻重掺磷、重掺砷衬底硅外延片；以及超平整度（Super Flat）硅抛光片等共计 11 类新产品，其中 8 类新产品已经进入批量供货，累计新产品发货量 43 万片。

开发了 BMD 增强工艺、金属吸杂工艺、轻掺单晶缺陷联合表征技术等 17 项 12 英寸新技术，大幅度改善了 Logic、CIS、BCD 等器件用硅片产品的体金属问题，解决了颗粒监控片产品经客户端重复使用后出现表面缺陷的问题，大大提升了硅片的可重复使用次数。

6-8 英寸硅片开发了低中压 MOSFET 器件用超低阻重掺磷、重掺砷衬底硅外延片、IGBT 和 FRD 器件用厚外延片、滤波器用超高阻硅抛光片等 40 余项新产品和新技术，并在主要客户量产产品上得到了全面应用，为新产品及时推出和产品性能提升提供技术保障。

在功率器件芯片领域，光伏用沟槽肖特基产品面对客户降本需求和其它 6 英寸、8 英寸晶圆厂竞争，完成了光伏用沟槽肖特基产品正向导通压降温度特性改善等新产品开发。电源用沟槽肖特基产品完成高压器件芯片原型产品工程验证。FRD 产品在重要客户量产顺利实施。在快恢复二极管产品、高压和超结 MOS 产品、IGBT 产品等方面，保证重要客户按计划推进产品开发及工程样品试制考核合格。全年共开发了 150 个新产品，转量产 75 个。

在化合物射频芯片领域，产品技术在多个创新领域有重大突破，技术水平进入全球第一梯队行列。整合并优化了化合物晶圆通用的铜柱工艺、开发了超突变结变容二极管工艺、超低噪声 0.13 μm pHEMT 工艺、低轨卫星用射频芯片等新工艺和新器件。射频芯片产品开始进入低轨卫星终端客户，并实现大规模出货。开发了二维可寻址 VCSEL 工艺技术，配合客户打通瞬时功率超万瓦的 VCSEL 阵列芯片，能充分适应车载雷达的技术指标需求，将是国内首个进入量产的大功率 VCSEL 技术，成为行业内首家量产二维可寻址激光雷达 VCSEL 芯片的制造厂商。碳化硅基氮化镓芯片的开发按计划节点顺利推进。在射频和激光领域，积极推进了近 20 项新技术的开发，并及时支撑客户超过 400 套研发版的流片验证和磨合，有效支撑客户量产流片。

2023 年度公司获得授权专利 15 件（发明专利 2 件、实用新型专利 13 件）。2023 年制定硅片领域国家标准 5 项，其中主持制定 1 项，参与制定 4 项。

3、射频业务表现亮眼，成为业绩增长新引擎

公司化合物半导体射频芯片业务在 2023 年进展迅速，表现亮眼。得益于产品技术实现完全突破，客户端验证已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户及下游手机的主要客户；得益于消费电子的复苏和进口替代加快，在手订单充裕，产能利用率同比大幅上升，产销量和营收达到历史峰值，负毛利率情况大幅收窄。在市场端，在稳定核心客户的基础上开发了诸多客户，客户群体超过 160 家，并成功进入知名手机品牌公司的供应链。

4、实施大客户战略，增强市场竞争力

公司深耕行业二十多年，拥有深厚的技术积累和产业规模优势，具有独具特色的产业链一体化优势，能为客户提供从材料到芯片的一站式解决方案。

半导体硅片板块充分发挥自身在功率芯片的单晶及外延产品的技术优势，进一步拓展与中芯国际、华润微、华虹半导体、比亚迪、上海积塔、芯联集成、士兰微、青岛芯恩、粤芯半导体、力积电、日本东芝、Onsemi、Vishay 等境内外知名集成电路客户的合作；

功率器件芯片板块产品进入隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、通威股份、协鑫科技、阿特斯等光伏终端和宏微科技、台湾半导体、Onsemi 等客户的供应链；

化合物射频芯片板块产品进入昂瑞微、唯捷创芯、慧智微、瑞识科技、锐石创芯、华芯天微、无锡芯百特、老鹰半导体、禾赛科技等知名企业的供应链。

2023 年随着公司车规产品、工控产品、微波射频产品的技术突破及快速上量，新收获了国内诸多领先的新能源汽车终端客户、手机等消费电子领域的头部终端客户。FRD 产品以一级供应商的身份进入国内某重要公司的供应链。高标准的产品质量要求和大客户行业领袖的优质属性将带动公司管理和技术的不断进步，增强公司市场竞争力。

5、建设项目有序实施，持续扩充产能规模

半导体公司的发展离不开产业规模化的投入，唯有如此，才可能实现规模效益，从而提升竞争力。

截止报告期末，半导体硅片方面，6 英寸抛光片（含衬底片）产能 60 万片/月、8 英寸抛光片（含衬底片）产能 27 万片/月、6-8 英寸（兼容）外延片产能 70 万片/月、12 英寸抛光片（含衬底片）产能 20 万片/月、12 英寸外延片产能 10 万片/月。功率器件芯片产能 23.5 万片/月，产品线包括了 6 英寸 SBD、FRD、MOSFET、TVS、IGBT。化合物射频芯片产能达到了 9 万片/年，产品线包括了 6 英寸微波射频芯片、VCSEL 芯片等。

报告期内，公司积极推进各生产基地新增产能的建设。衢州基地年产 600 万片 6-8 英寸硅抛光片项目稳步推进中，预计于 2024 年 9 月完成 25 万片/月 8 英寸新增产能设备的移机工作。衢州基地年产 180 万片 12 英寸硅外延片项目正在建设过程中。嘉兴基地 12 英寸硅抛光片扩产项目正在按计划推进中，预计 2024 年底将达到 15 万片/月的产能。海宁基地年产 36 万片 6 英寸微波射频芯片及器件生产线项目完成土建工程，开始了主要甲供设备、特气工程包、化学品工程包等招标工作，预计于 2024 年第四季度建成 6 万片/年的产能并投入商业运营。

6、积极推进产品认证，不断提高质量保证能力

在产能充裕、需求低迷、竞争激烈的市场背景下，客户对产品的质量要求越来越高，对体系建设的规范更加看重，现场审核也更趋严格。报告期内，公司各业务板块根据产线与产品实际，重点推进质量管理体系建设，促进体系完善与落实，确保从流程到产品的全面把控。衢州基地高压 MOSFET 用 200mm 硅外延片、200mm 重掺磷直拉硅单晶抛光片通过了品字标浙江制造认证，提高了产品的专业性和知名度。嘉兴基地 ISO9001 已获体系认证，ISO14001、IATF16949 认证也已进入尾声阶段。功率器件芯片业务板块通过了一家国内某重要公司、韩国 KEC 公司的验厂审核，并进入批量供货阶段。通过了比亚迪、宏微科技等重要客户的年度审核。射频芯片业务板块通过 16949:2016、SGS ITAF 车规认证，通过小米、联想、比亚迪等 14 家客户审厂，接待 VIVO、荣耀等近十家客户验厂。

7、发挥链主优势，推动产业链上下游协同发展

金瑞泓作为集成电路材料领域的链主企业，在产业链相关领域，通过供应链合作、联合项目攻关、直接或间接股权投资等多种形式培育和发展半导体供应链企业，通过积极的横向与纵向资源整合，最大程度发挥协同效应，进一步加强与客户之间、与供应商之间的合作黏性，共同推动半导体相关产业的国产化进程。报告期内，金瑞泓筹建了浙江省半导体材料创新联合体，公司参与了产业链重要客户芯联集成电路制造股份有限公司科创板首发上市的战略配售及软件供应商上海赛美特软件科技股份有限公司的 B 轮融资。

2023 年，公司及子公司浙江金瑞泓均获国家级“专精特新”小巨人企业认定；衢州金瑞泓和金瑞泓微电子双双入选浙江省“专精特新”中小企业和衢州市工程技术研发中心；立昂东芯实施的“高线性 GaN 芯片研发”项目被列为 2024 年度浙江省尖兵计划项目；浙江金瑞泓获得宁波市首届标准创新重大贡献奖。浙江金瑞泓入选第五届（2023 年）中国电子材料行业半导体材料前十企业榜单、第五届（2023 年）中国电子材料行业综合排序前 50 企业榜单。

公司主营业务主要分三大板块，分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片。主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片；6 英寸 SBD（肖特基二极管）芯片、6 英寸 FRD（快恢复二极管）芯片、6 英寸 MOSFET（金属氧化层半导体场效应晶体管）芯片、6 英寸 TVS（瞬态抑制二极管）芯片及 6 英寸 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）芯片；6 英寸砷化镓微波射频芯片、6 英寸 VCSEL（垂直共振腔表面发射激光器）芯片等三大类。三大业务板块产品应用领域广泛，包括 5G 通信、智能手机、计算机、汽车产业、光伏产业、消费电子、低轨卫星、智能电网、医疗电子、人工智能、物联网等终端应用领域。经过二十多年的发展，公司已经成长为目标国内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台，形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研发和产业化，以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件芯片业务带动化合物半导体射频芯片

产业的经营模式，很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜力，为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

1、半导体硅片业务

虽然市场下滑，但工业控制、汽车电子等细分领域持续复苏，带动所需硅片市场有所增长。在主要客户投片量缩减，公司产能利用率走低的情况下，公司及时调整销售策略，不断优化产品结构，快速准确响应客户个性化需求，重点发挥重掺产品优势，确保在客户端的市占率稳步提升。公司 12 英寸产品已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路，以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件，并进一步挖掘产品类型，继续拓展新的客户群，抢占市场份额。在小尺寸上重点突破老客户的增量，保持了全年半导体硅片业务的相对稳定。

报告期内，公司半导体硅片营业收入 179,210.59 万元(含对立昂微母公司的营业收入 29,084.29 万元)，相比上年同期下降 10.94%。从销售数量来看，折合 6 英寸的销量为 984.36 万片（含对立昂微母公司的销量 192.50 万片），较上年同期增长 0.72%，其中 12 英寸硅片销售 49.86 万片（折合 6 英寸为 199.42 万片），较上年同期增长 35%。

公司部分募投项目自 2022 年 6 月开始陆续转产，相应的折旧费用等固定成本增加较多，但自 2022 年下半年以来，受消费电子市场需求下滑影响，硅抛光片产能利用率下降，部分硅片产品价格有所下调。由于受经济疲弱影响，衢州基地的 12 英寸硅片仍处于产能爬坡中；2022 年 3 月份收购了嘉兴金瑞泓，产能处于爬坡过程中。报告期内，受益于功率半导体需求稳定，公司硅外延片产能利用率充足。

2、半导体功率器件芯片业务

由于 2023 年全球“碳中和”“碳达峰”进程的深入推进，光伏等清洁能源产业的发展十分强劲，新能源汽车等新能源交通产业的发展保持了较高的成长性，相关的半导体功率器件需求增量巨大，部分冲抵了消费电子类功率器件市场的不景气。

报告期内，公司充分发挥自身产业链一体化的优势，以不断的技术创新与稳固的技术合作充分满足客户的多样化需求，面对日趋激烈的市场竞争，进一步丰富产品系列、优化产品结构、拓展优质客户，围绕光伏与车规两大产品门类，优先扩大沟槽产品销售规模及占比，稳定提升 FRD 产品的产销占比，加快 IGBT 等产品的开发，从而确保了全年功率器件芯片业务产销量再创历史新高。其中光伏类产品高位增长，在全年全球光伏类芯片销售中占比 37%左右，车规类产品客户群继续扩大。

报告期内，公司半导体功率器件芯片营业收入 102,923.95 万元，相比上年同期下降 4.56%。从销售数量来看，销量为 171.58 万片，较上年同期增长 8.87%，其中沟槽芯片销售 89.97 万片，较上年同期增长 35%；FRD 芯片销售 9.81 万片，较上年同期增长 80.16%，IGBT 芯片开始批量供货。

3、化合物半导体射频芯片业务

受益于产品技术实现完全突破，客户验证顺利，射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，国产替代加速；多规格、小批量、多用途、高附加值的特殊用途产品持续放量，低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货。在客户总量、订单数、产能利用率、出货量、销售额等方面均有大幅度增长，负毛利率情况大幅收窄。

报告期内，公司化合物半导体射频芯片实现营业收入 13,734.95 万元，相比上年同期增长 171%。从销售数量来看，销量为 1.79 万片，较上年同期增长 141.19%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,827,599.25	1,854,162.38	-1.43	1,256,063.14
归属于上市公司股东的净资产	797,235.30	820,453.57	-2.83	754,242.55
营业收入	268,966.99	291,421.63	-7.71	254,091.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	266,785.20	287,536.70	-7.22	250,961.51
归属于上市公司股东的净利润	6,575.25	68,778.99	-90.44	60,030.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,552.44	55,653.97	-118.96	58,399.02
经营活动产生的现金流量净额	102,679.73	119,454.25	-14.04	43,752.86
加权平均净资产收益率(%)	0.82	8.91	减少8.09个百分点	20.09
基本每股收益(元/股)	0.10	1.02	-90.20	1.46
稀释每股收益(元/股)	0.10	1.02	-90.20	1.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	63,223.65	70,998.97	67,057.34	67,687.03
归属于上市公司股东的净利润	3,443.71	13,921.17	1,173.58	-11,963.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,349.16	2,653.36	1,069.02	-16,623.98
经营活动产生的现金流量净额	9,698.03	27,247.27	18,738.57	46,995.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

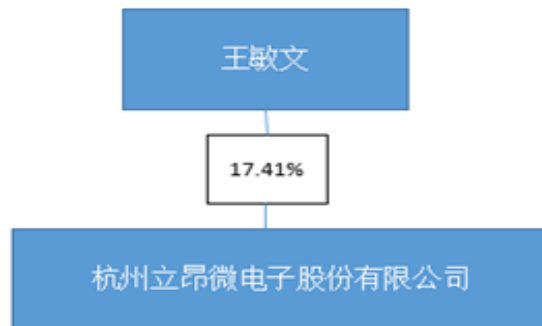
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					82,639		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					78,016		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王敏文		117,831,266	17.41		质押	42,000,000	境内自然 人
衢州泓祥企业管理合 伙企业（有限合伙）		39,958,224	5.90		无		其他
宁波利时信息科技有 限公司	-2,410,869	31,369,855	4.63		质押	31,345,000	境内非 国有法 人
国投创业投资管理有 限公司—国投高新 （深圳）创业投资基 金（有限合伙）	-379,500	20,169,527	2.98		无		其他
香港中央结算有限公 司	3,267,134	14,723,530	2.18		无		境外法 人
衢州泓万企业管理合 伙企业（有限合伙）		12,267,878	1.81		无		其他
王式跃		9,763,286	1.44		无		境内自然 人
国泰君安证券股份有 限公司—国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金	3,730,910	9,170,405	1.35		无		其他
韦中总	-196,400	8,777,671	1.30		无		境内自然 人
贾银凤	-190,212	8,534,188	1.26		无		境内自然 人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有泓祥投资 78.50% 出资份额，持有泓万投资 55.16% 出资份额，为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

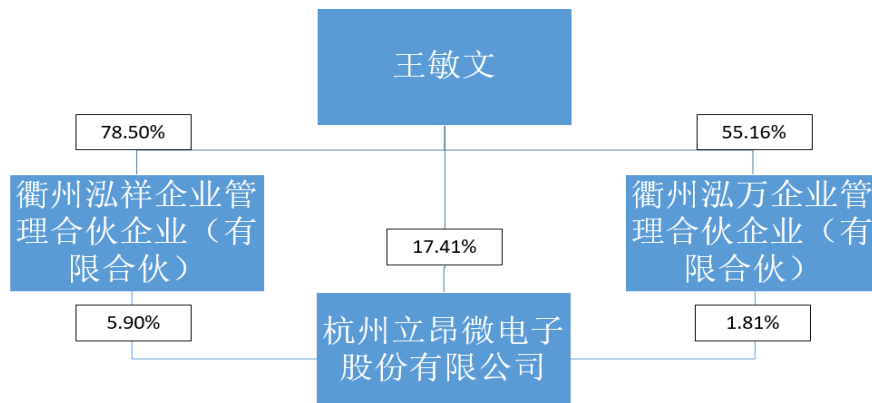
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 268,966.99 万元，较上年同期下降 7.71%；实现营业利润-9,870.76 万元，较上年同期下降 113.78%；剔除利息、折旧摊销等因素的影响后，EBITDA（息税折旧摊销前利润）为 86,696.93 万元，较上年同期下降 35.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,575.25 万元，较上年同期下降 90.44%，经营业绩下降的原因主要有：2023 年度受整体经济环境和半导体市场下行周期的影响，公司主要产品降价导致毛利率大幅下降；产能扩产带来的成本压力；收购嘉兴金瑞泓产生阶段性的亏损；计提的可转换债券利息费用大幅增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用